

# 卷頭言



## 副会長に就任して

松澤 昭\*

この度、本会の副会長を務めることになりました。実は私はアナ・デジ混載SoCなどの集積回路の設計に携わり、信学会やIEEEで活動して参りましたが、本会での活動経験はあまりございません。したがって、何で私が副会長なのか不思議なのですが、多分これは時代の巡り合わせのせいだと考えております。

と申しますのは、現在、集積回路の世界は大きな転換点にさしかかっているからです。元々、実装技術は基板実装から始まっているのですが、信頼性やコストの限界がありました。シリコン集積回路技術という、信頼性に優れ、しかも微細化により性能が上がると同時にコストが下がるという夢のような技術が開発されたために、過去40年以上にわたりエレクトロニクスを牽引する役割を果たしてきました。しかしながら現在、微細化の限界、技術の巨大化やコモディティ化の波が訪れております。最近はプロセス・デバイス関係の国際学会の投稿件数が減少し、発表分野も実装技術に近いSiPや3次元IC関係が増加しております。

かつては集積回路技術が進歩すればほとんどのデバイスが集積され、実装技術は不要になるという予測もありましたが、実際はインターフェースの高速化や高周波部品およびセンサとの接続、ノイズの輻射や放熱対策、立体集積化など、実装技術に対する期待、つまり付加価値の源泉が実装にあるという認識が非常に高くなり、まさに本会の出番となっております。

しかしながら、本会が社会からの期待の受け皿になり、この分野を生き生きと発展しうるかということになるといろいろな面で不十分なようです。本会での経験の浅い私が申し上げるのは僭越ですが、学会運営の仕組みと体制、論文や発表の量と質、若手の育成体制、国際的活動など、改善すべき点が多くあるのではないかでしょうか。

ところで、私は現在、信学会の集積回路研究専門委員会の委員長を務めております。この研究会は年に10回程度開催し、250件程度の発表を行っている活発な研究会ですが、運営がややマンネリ化していたため、約半年をかけて改革委員会で論議し、改革プランを策定しました。骨子は、「若手の人材育成」および「技術論議の深化と活発化」です。本年度はこの方針に沿って招待講演やパネル討論の充実、コメントーター制の導入、「夏の学校」、「若手研究会」の新設などを実施していますが、非常に好評のようです。やはり学会は次世代を担う人材を育成する場として機能すべきですし、時代に合った新たな取り組みを行えば必ず人は集い、活性化するものと確信しております。本会が社会の期待に応え、より活性化するよう尽力いたしますので、遠慮なくお声をお掛けください。

\* 本会副会長／東京工業大学大学院理工学研究科教授